

4971 **メック**

前田 和夫 (マエダ カズオ)

メック株式会社社長

グローバル展開を強化し、事業領域の拡大を目指す

◆決算業績概要と来期業績予想

平成 26 年 3 月期の売上高は 80 億 3 百万円で、前期比 12 億 99 百万円の増収となり、平成 26 年 1 月 31 日発表の修正計画を 2 億 3 百万円上回った。為替による影響は 6 億 86 百万円である。薬品売上は前期比 12 億 59 百万円増の 73 億 53 百万円で売上高の 91.9%を占める。そのうち、海外売上高比率は 48.7%である。CZ 売上高は 37 億 5 百万円で、薬品売上高に占める割合は 50.4%と若干減少したものの、半分程度を維持している。なお、当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は 66.9%に達する。機械売上は前期比 30 百万円増、資材売上は同 28 百万円増であった。

売上総利益は前期比 8 億 10 百万円増、販管費および一般管理費は同 3 億 6 百万円増で主要因は為替による影響と人件費増加である。その結果、営業利益は同 5 億 3 百万円増の 14 億 21 百万円で修正計画を 1 億 21 百万円上回り、経常利益は 5 億 95 百万円増の 15 億 51 百万円で修正計画を 1 億 1 百万円上回ることができた。粗利率は 62.0%となっている。その他、欧州での訴訟関連債務戻入益は前期で終結し、また、日本国内有休土地の減損 43 百万円などがあった。当期純利益は前期比 2 億 98 百万円増の 9 億 25 百万円となったが、子会社の留保金に対する為替要因により修正計画には 74 百万円(7.5%)及ばなかった。

現金および預金は売上債権回収に伴って 13 億 61 百万円増加した。土地は減損 43 百万円があったものの為替差益による増加が 85 百万円あり、全体としては増加している。投資有価証券は株式時価上昇によって増加した。退職給付に係る資産は退職給付会計基準変更によるものである。負債については、短期借入金と銀行借入金返済により減少し、未払金が設備関係未払金や未払消費税等により増加している。繰延税金負債は子会社留保金の増加、および退職給付会計基準変更により増加した。なお、この退職給付会計基準変更に伴い、資本に 71 百万円の調整金が計上されている。

四半期別にみると売上・利益とも第 3 四半期がピークで第 4 四半期は少し落ちているが、これは正月等季節的な要因であり、当社は例年このような傾向にある。

薬品別では銅表面処理剤が圧倒的に多い。また、CZ を中心とした密着向上剤と、配線パターン形成用 EXE などのエッチング剤の比率も例年どおりの傾向で推移している。

地域セグメント別売上高推移と海外比率をみると、日本では第 4 四半期に売上高が減少しているが、アジアでは堅調を維持した結果、海外売上高比率が上昇した。

平成 27 年 3 月期の通期連結業績は、売上高 83 億円(前期比 103.7%)、営業利益 15 億円(同 105.5%)、経常利益 15 億 60 百万円(同 100.5%)、当期純利益 10 億円(同 108.1%)と予想している。

◆今後の事業展開

当社の製品は電子機器全般に使われており、パソコンやスマートフォン、タブレット PC 向け電子部品の製造用薬品では世界的に高いシェアを獲得している。それに加えて最近では自動車向けが増え、期待しているところであ

る。

当社の基幹技術としては、現在、「密着向上技術」、「微細配線形成技術」、「金属表面処理技術」の3つがある。

密着向上技術は昔から当社の得意分野で売上に最も貢献しているものである。物理密着技術は銅の表面を粗化して樹脂を密着させるものでCZシリーズやVボンドがあり、化学密着技術は平滑な面で密着強度を得る技術であるが、今後は化学密着技術に注力していく必要があると考えている。

微細配線形成技術は微細な配線パターンを形成する技術で、EXEシリーズのサブトラエ法技術、TPシリーズのITO処理技術がある。EXEシリーズはテレビ関係で世界標準となっており、TPシリーズはタッチパネルなどに利用されている。

金属表面処理技術には、金属表面を粗化する表面粗化技術と、同じベース上にある金属のうち特定のものだけエッチングする選択エッチング技術がある。当社では、銅、ニッケル、アルミ、サス(SUS)、鉄、チタンなどさまざまな金属を扱っており、今後の展開が楽しみである。

これらの技術を使った製品は、スマートフォン、タブレットPC、テレビ、自動車、PCおよびサーバー、基地局など、多岐にわたっている。スマートフォンやタブレットPCは成熟期に移行しつつあるので歩留まり向上、生産性向上が求められており、当社製品の需要は増加している。また、テレビにおいても、地デジ化が一段落し、安く正確でコンパクトに製造するために当社製品の採用が進んでいる。自動車は成長産業であり、エレクトロニクスも進化している。PCは横ばいまたは下降傾向であるが、サーバーに対する需要は増加している。さらに、スマートフォンやタブレットPCのアプリケーションプロセッサ用パッケージ基板では、従来6層あるうちの最外層だけが対象となっていたが、内層処理にも本格的に使用され始めたため、期待できると考えている。

◆事業領域の拡大を目指して

密着向上技術においては、銅配線パターンの幅をできるだけ微細化し、また信号の周波数も高周波化が求められている。そのため、従来の物理密着技術だけではなく、エッチングレス、つまり平滑な面に高密着させるための化学密着技術が必要となっており、今後はこちらが主力になると考えている。

当社では高周波基板用密着向上剤として化学密着剤フラットボンドGTプロセスの販売を開始した。また、自動車では現在、自動運転・無人運転や自動ブレーキの技術が競われているが、こういったスピードが要求される技術にも当社製品が有効である。

また、微細配線形成技術の主な市場としてテレビがあるが、薄型・大型のものほど当社のEXEシリーズが標準的に使用されている。テレビのロードマップとしては、サッカーW杯やブラジル夏季オリンピック、韓国冬季オリンピック、2020年東京オリンピックといったイベントに加えて、4K・8Kといった次世代テレビの試験放送・商用放送が予定されており、また、ブラジル・中国・ロシアなどこれからデジタルテレビ化を控えている国もある。8Kなどは非常に高精度な画像なので3D技術と組み合わせて内視鏡手術に応用するなど新しい可能性も考えられる。このように、テレビやフラットパネルディスプレイ向けというのは、今後も安定的に推移するのではないかと期待している。

一方、金属表面処理技術「アマルファ」は金属表面を粗化していろいろな樹脂と接着させるものである。銅、SUS、アルミ、ニッケル、鉄、チタンなどいろいろな金属に対応しており、自動車、モバイル端末、エネルギー関係などを対象にじっくり取り組んでいるところである。

以上のように、当社は従来電子基板製造関連分野に関わってきたが、今後はディスプレイ関連分野や樹脂金属接合関連分野など、新しい事業領域を拡大していきたいと考えている。

◆これからの成長に向けて

当社の製品は最終的に世界市場が相手であり、今後も引き続きグローバル展開を強化していく。

また、新製品はやはり利益をもたらすので、新製品の開発力も強化していきたい。新しいニーズに対応し、シーズを育てていく。さらに、トータルな品質保証の強化としては、日本のメーカーとしてサービスを含めた質については新興国の追随を許すわけにはいかない。独創の技術と開発力を持ち、2020年、2025年にはさまざまところで花を咲かせられるよう、着実に成長していきたい。

◆ 質 疑 応 答 ◆

第4四半期について、利益の減少幅が大きい理由は何か。

第4四半期は正月の関係で12月に前倒し受注があり、第3四半期より売上・利益とも下がるのが通例だ。今回は円安の影響による海外子会社の販管費増加が大きな要因となっている。

営業利益予想について、上下期同額で見込んでいるのはなぜか。

上期はスマートフォンのアプリケーションプロセッサなど具体的な需要が見込まれているが、下期は不透明なため、同額で置いている。

CZの売上予想について伺いたい。

CZの売上は、PCでは減少、サーバーやスマートフォンは増加、車載は若干増加で、前期比1億円増の38億円程度を見込んでいる。

新しい事業所の再検討について伺いたい。

当社では研究開発を中心に売上の10%以上を投資するべきだと考えている。2002年には研究棟への投資があったが、その後、リーマンショックや震災等の状況により投資を一旦中断した時期もあった。しかし、今後の展開を見据え、ニーズに対応しシーズを仕上げるためにも、準備すべき時期であると判断した。

売上について足元の状況を伺いたい。

海外では台湾・韓国中心に半導体やOSP関係が活況である。日本ではスマートフォンやタブレットのディスプレイ関係が今後伸びてくると思われる。

EXEの需要について伺いたい。

EXEについては、パッケージ基板やモバイルのマザーボードなど、量産のテスト中である。

(平成26年5月13日・東京)

* 当日の説明会資料は以下のHPアドレスから見ることができます。

http://www.mec-co.com/ir/k_setsumei/